

# 有価証券報告書の訂正報告書

(第13期)

自 平成19年4月1日  
至 平成20年3月31日

**株式会社アクセル**

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成20年11月10日
【事業年度】	第13期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）
【会社名】	株式会社アクセル
【英訳名】	AXELL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 謙
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番1号
【電話番号】	(03) 5298-1670
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループゼネラルマネージャー 千代 進弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番1号
【電話番号】	(03) 5298-1670
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループゼネラルマネージャー 千代 進弘
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャスダック証券取引所 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年6月23日に提出いたしました第13期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 3 事業の内容

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

##### 3 対処すべき課題

##### 4 事業等のリスク

##### 7 財政状態及び経営成績の分析

#### 第4 提出会社の状況

##### 3 配当政策

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_罫で示しております。

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 3【事業の内容】

##### (1) 事業の概要について

(訂正前)

当社は、グラフィックス及びサウンドに向けたASSP製品の開発・販売を主たる事業とする研究開発型ファブレス（注1）半導体メーカーであります。また、当社では、技術的先進性等の観点から当社の技術力が特に発揮できると認められる場合など特段の要因が存する場合に関して、ASIC製品の開発を受託しております。

現在、当社事業の中核を構成するASSP製品は、遊技機器市場向けのグラフィックスLSI製品であり、同市場における市場占有率（注2）は概ね50%程度になるものと分析しております。

<中略>

(注) 2. 当有価証券報告書に記載する「市場占有率」は、一般に公開されている各種資料を基に同市場から得られるその他の資料を加味して、当社が算定した数値です。

<中略>

##### ① ASSP製品

現在、当社の主なASSP製品は、遊技機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品「AG301」・「AG-2」シリーズ、サウンドLSI製品「AS201」、LEDドライバLSI製品「AL-1」シリーズ、メモリモジュール製品及び組み込み機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品「AG-9」シリーズ等であります。

遊技機器市場へ向けた製品として現在主力となっているグラフィックスLSI製品「AG301」は、SXGA（注1）の解像度に対応する高解像度化を実現するとともに新たに開発した動画像圧縮伸長技術「RM2（注2）」を搭載し、更に3Dグラフィックスにも対応できる機能を有しております。

同市場に向けたサウンドLSI製品「AS201」は、音声圧縮伸長技術を搭載するとともに音源データの再生方

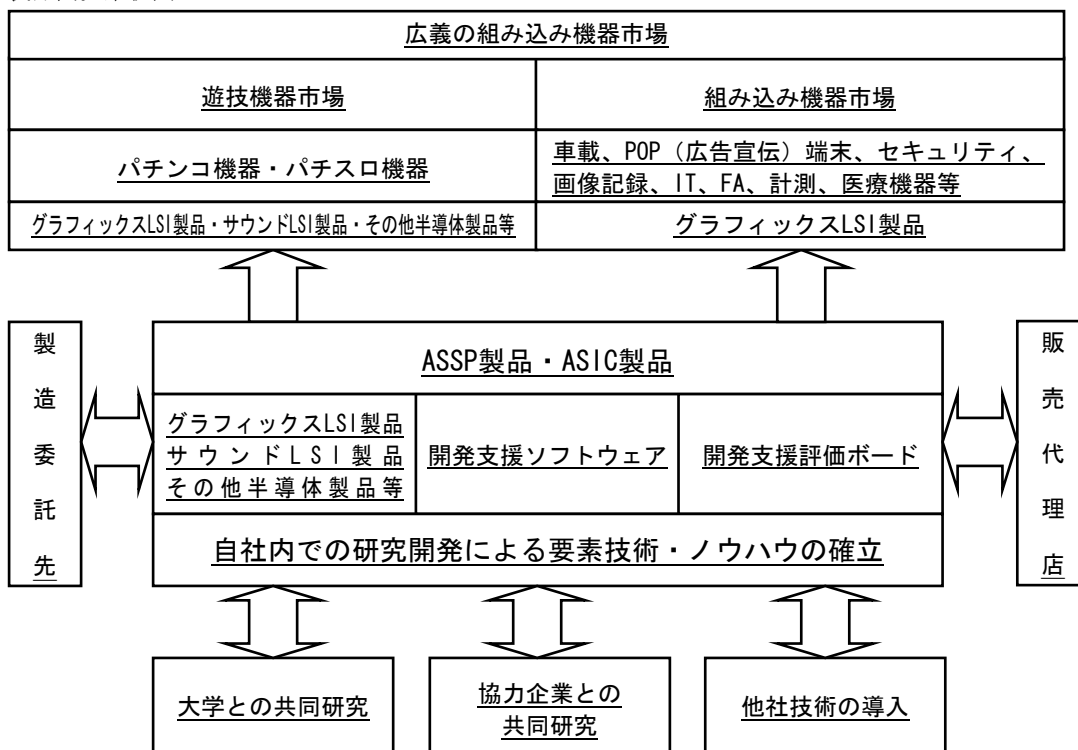
式等に特長的機能を有しております。また、LEDドライバLSI製品「AL-1」シリーズは、LED制御基板とLEDを結ぶ配線の大幅な削減が図れる製品となっており、メモリモジュール製品は、遊技機器の液晶表示部に映像を表示する画像データを保持するメモリを搭載する基板製品となっております。

組み込み機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品は、「AG-9」シリーズとして「AG901」と「AG902」の2製品を開発・販売しております。これらの製品は、組み込み機器においてSXGAの高解像度画像表示の実現を目的としており、多様な機器への応用を前提とした幅広い機能を有する製品となっております。特に「AG902」につきましては、独自開発による静止画像圧縮伸長技術「RS1（注3）」を搭載しており、外部から取り込まれた画像データの保存・再生や遠隔地間の画像データの送受信を想定する機器への応用が可能な製品となっております。

- (注) 1. 「SXGA」は、Super eXtended Graphics Arrayの略称であり、1280×1024画素の解像度を意味しています。
2. 「RM2」とは、RAPIC Movie Compression Ver.2の略称であり、当社が独自に開発した動画画像圧縮伸長技術の名称です。また、「RAPIC」は、当社が開発する圧縮伸長技術の総称であり、登録商標です。

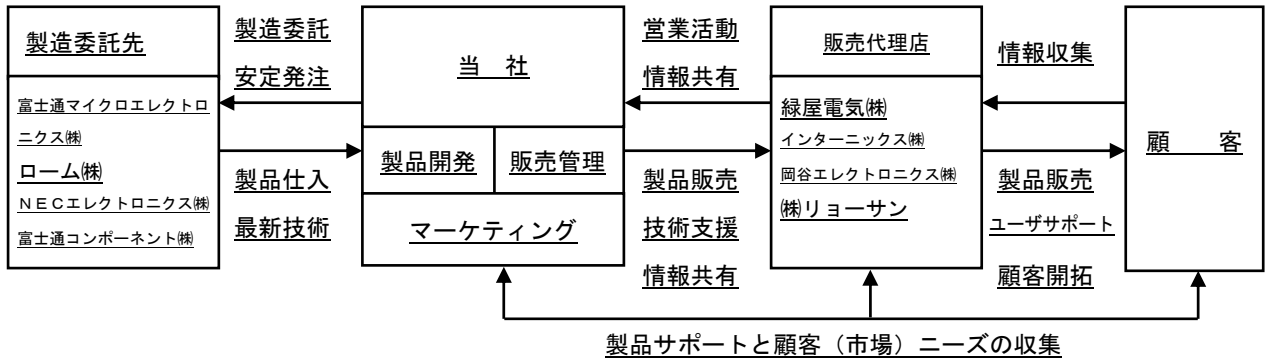
<中略>

図-1 製品開発系統図



<中略>

図-2 事業系統図



<後略>

(訂正後)

当社は、グラフィックス及びサウンドに向けたASSP製品の開発・販売を主たる事業とする研究開発型ファブレス（注1）半導体メーカーであります。また、当社では、当社が研究開発に注力している分野（注2）において当社の技術力が特に発揮できると認められる場合など特段の要因が存する場合に関して、ASIC製品の開発を受託しております。

現在、当社事業の中核を構成するASSP製品は、遊技機器市場向けのグラフィックスLSI製品であり、同市場における製品販売数量は平成20年3月期において230万個となっております。

<中略>

(注) 2. 当社は、主に組み込み機器で使用される仕組みにおいて高解像度描画表示を実現する技術や圧縮伸長技術の研究開発に注力しております。

<中略>

① ASSP製品

現在、当社の主なASSP製品は、遊技機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品、サウンドLSI製品、LEDドライバLSI製品、メモリモジュール製品及び組み込み機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品等であります。上記製品の中で当社事業の中核に位置づけられる遊技機器市場向けグラフィックスLSI製品「AG301」は、XGAサイズの解像度に対応する高解像度化を実現するとともに新たに開発した動画像圧縮伸長技術「RM2（注1）」を搭載し、更に3Dグラフィックスにも対応できる機能を有しております。

同市場に向けたサウンドLSI製品は、音声圧縮伸長技術を搭載するとともに音源データの再生方式等に特長的機能を有しております。また、当事業年度から本格的量産販売を開始したLEDドライバLSI製品「AL-1」シリーズは、LED制御基板とLEDを結ぶ配線の大幅な削減が図れる製品となっております、メモリモジュール製品は、遊技機器の液晶表示部に映像を表示する画像データを保持するメモリを搭載する基板製品となっております。

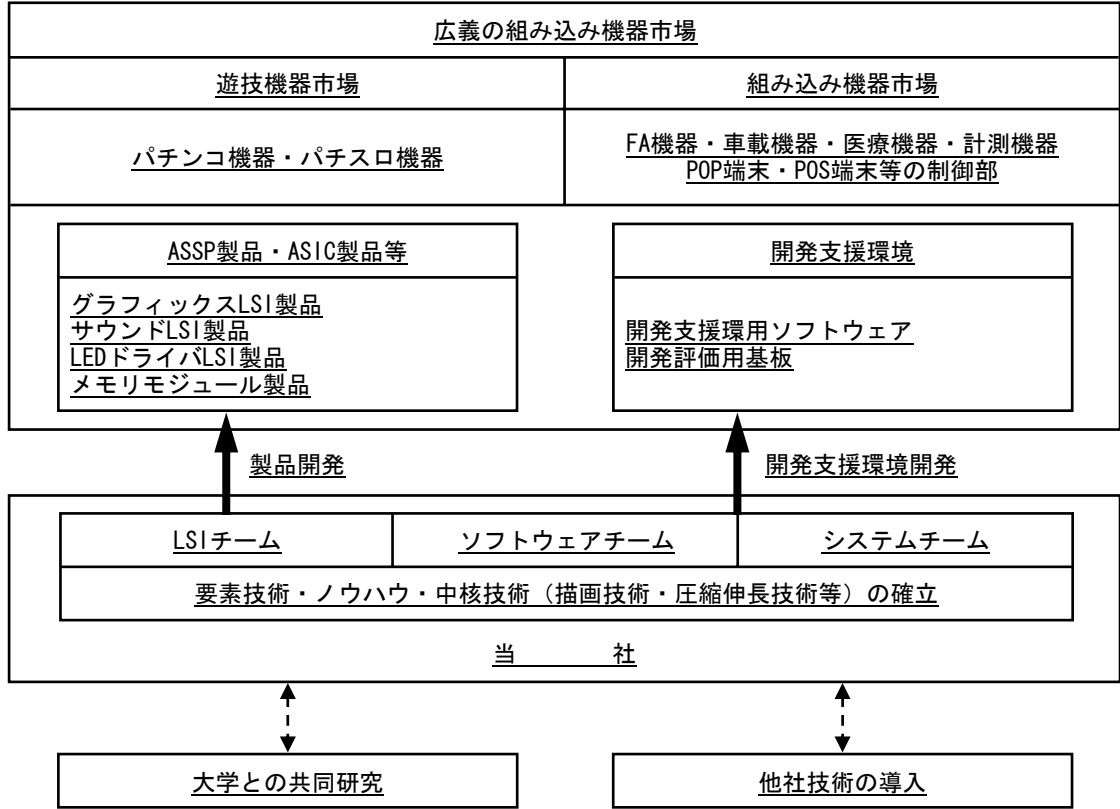
また、遊技機器市場以外の組み込み機器市場へ向けたグラフィックスLSI製品「AG-9」シリーズは、組み込み機器においてSXGA（注2）の高解像度画像表示の実現を目的としており、多様な機器への応用を前提とした描画表示能力を持たせるとともに、一部製品には静止画圧縮伸長技術「RS1（注3）」を搭載することで外部から取り込まれた画像データの保存・再生や遠隔地間の画像データの送受信を想定する機器への応用が可能な製品となっております。

(注) 1. 「RM2」とは、RAPIC Movie Compression Ver.2の略称であり、当社が独自に開発した動画像圧縮伸長技術の名称です。また、「RAPIC」は、当社が開発する圧縮伸長技術の総称であり、登録商標です。

2. 「SXGA」は、Super eXtended Graphics Arrayの略称であり、1280×1024画素の解像度を意味しています。

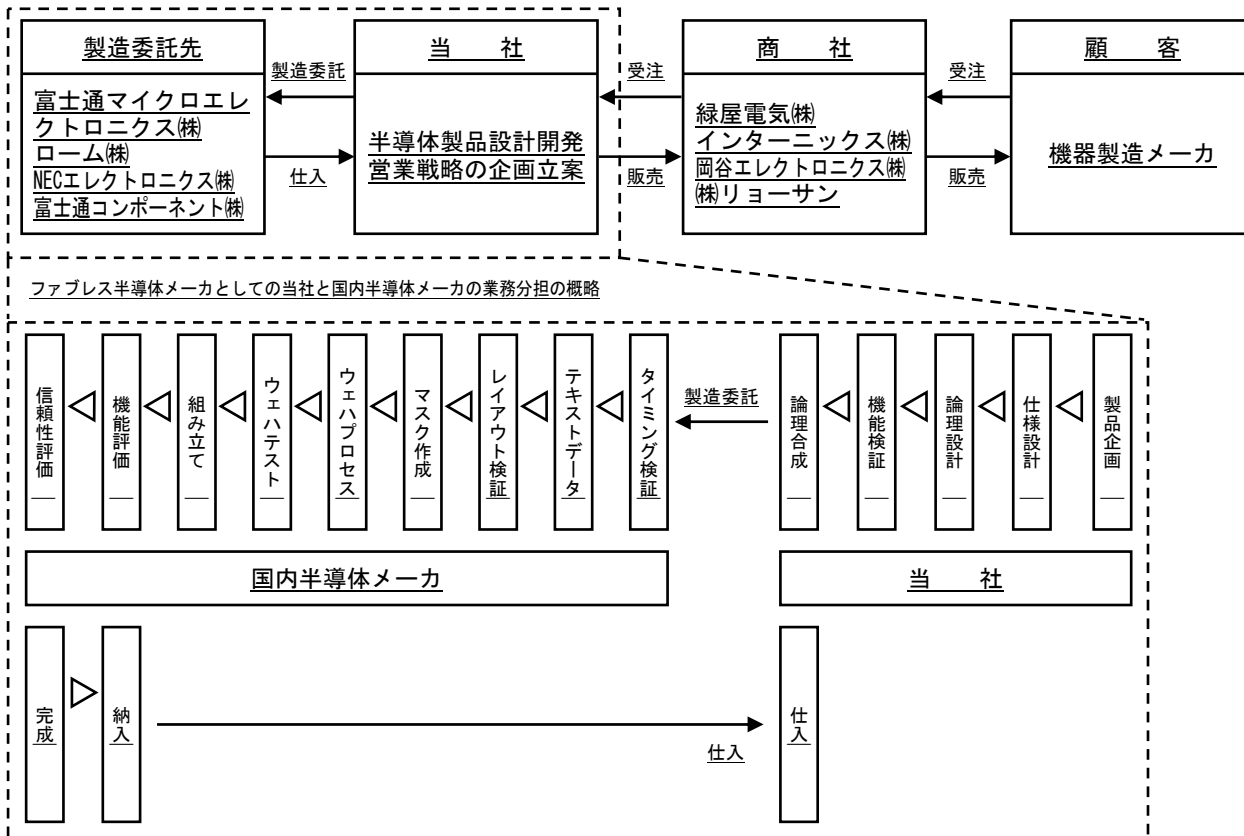
<中略>

図-1 製品開発系統図



< 中略 >

図-2 事業系統図



<後略>

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

<前略>

#### ① ASSP製品

当事業年度における遊技機器市場は、大型液晶表示装置を搭載し高解像度での画像表示を実現したパチンコ機器の本格的な導入と遊技機器に係る規則改正を受けた新基準に適合したパチスロ機器への相当規模の入替がありました。前段の市場動向に対しましては、SXGAの解像度に対応する新しいグラフィックスLSI製品「AG301」の本格的な量産販売を期初から開始しており、当初計画した「AG-2」シリーズからの移行速度を上回る需要動向となりました。また、後段のパチスロ機器の入替需要に関しましては、同機器の年間製造台数が減少した可能性があるとの厳しい動向分析もなされておりますが、当社グラフィックスLSI製品の従前主力製品であります「AG-2」シリーズの採用が増加しました。これらの動向を受け、同市場向けグラフィックスLSI製品の販売数量は、概ね前事業年度並みとなりました。また、同市場に向けたグラフィックスLSI製品以外の製品といたしましては、当事業年度から本格的な量産販売が開始されたLEDドライバLSI製品「AL-1」シリーズの販売が順調に進展するとともに、サウンドLSI製品「AS201」及び組み込み機器市場向けグラフィックスLSI製品「AG-9」シリーズも当初計画に沿う販売動向となりました。更に、メモリモジュール製品に関しましては、翌事業年度期初からの本格量産販売を想定しておりましたが、搭載予定遊技機器に係る製造販売計画が前倒しとなったことから、当事業年度第4四半期からの本格量産販売となりました。

以上の結果、当事業年度におけるASSP製品の売上高は13,784百万円（前年同期比74.7%増）となりました。

② ASIC製品

当事業年度におきましては、組み込み機器市場に向けたグラフィックスLSI製品として過年度に開発したASIC製品の販売を継続して行いました。

以上の結果、当事業年度におけるASIC製品の売上高は、9百万円（前年同期比51.7%減）となりました。

(訂正後)

<前略>

① ASSP製品

(遊技機器市場向け製品)

当事業年度における遊技機器市場は、大型液晶表示装置を搭載し高解像度での画像表示を実現したパチンコ機器の本格的な導入と遊技機器に係る規則改正を受けた新基準に適合したパチスロ機器への全面的な入替がありました。前段の市場動向に対しましては、SXGAの解像度に対応する新しいグラフィックスLSI製品「AG301」の本格的な量産販売を期初から開始しており、当初計画した「AG-2」シリーズからの移行速度を上回る需要動向となりました。また、後段のパチスロ機器の入替需要に関しましては、同機器の年間製造台数が減少した可能性があるとの厳しい動向分析もなされておりますが、当社グラフィックスLSI製品の従前主力製品であります「AG-2」シリーズの採用が増加しました。これらの動向を受け、同市場向けグラフィックスLSI製品の販売数量は、概ね前事業年度並みとなりました。また、同市場に向けたグラフィックスLSI製品以外の製品といたしましては、当事業年度から本格的な量産販売が開始されたLEDドライバLSI製品「AL-1」シリーズの販売が順調に進展するとともに、サウンドLSI製品「AS201」も概ね堅調な販売動向での推移となりました。更に、メモリモジュール製品に関しましては、翌事業年度期初からの本格量産販売を想定しておりましたが、搭載予定遊技機器に係る製造販売計画が前倒しとなったことから、当事業年度第4四半期からの本格量産販売となりました。

(組み込み機器市場向け製品)

組み込み機器向けグラフィックスLSI製品につきましては、181百万円の売上高となり概ね前事業年度並みの推移となりました。

以上の結果、当事業年度におけるASSP製品の売上高は13,784百万円（前年同期比74.7%増）となりました。

② ASIC製品

(遊技機器市場向け製品)

当事業年度におきましては、遊技機器市場向けASIC製品に係る新規開発の受託はなく、製品販売も在りませんでした。

(組み込み機器市場向け製品)

当事業年度におきましては、組み込み機器市場に向けたグラフィックスLSI製品として過年度に開発したASIC製品の販売を継続して行いました。

以上の結果、当事業年度におけるASIC製品の売上高は、9百万円（前年同期比51.7%減）となりました。

### 3【対処すべき課題】

(訂正前)

<前略>

#### ③ 知的財産権の保護

当社は、知的財産権の重要性を強く認識し、当社製品又はその技術等に関して特許戦略的判断に基づいた特許権の取得を推進しております。

現在の取組みといたしましては、従業員の知識の向上を目的としたセミナーの開催や顧問弁理士による定期的な社内相談窓口の設置等を継続実施しております。今後におきましても、知的財産権に係る当社研究開発要員の事務負担の軽減と知的財産戦略の強化に向けた事務環境の整備に取り組んでまいります。

<後略>

(訂正後)

<前略>

#### ③ 知的財産権の取得及び保護に対する取組みの強化

当社は、知的財産権の取得及び保護の重要性を強く認識しており、当社製品又はその技術等に関して特許戦略的判断に基づいた特許権の取得に向けた体制の充実が課題であると認識しております。また、自社開発に係る知的財産権の保護と他社の知的財産権侵害の回避につきましても、今後の業容拡大を踏まえた体制強化が課題になるものと考えております。上記の点に関する現在の取組みといたしましては、知的財産権の取得に関して、従業員の知識の向上を目的としたセミナーの開催や顧問弁理士による定期的な社内相談窓口の設置等を実施しており、継続的な環境整備に取り組んでおります。また、自社及び他社の知的財産権の保護につきましては、各種調査を実施することで、随時侵害の有無を確認する体制を構築しております。

<後略>

### 4【事業等のリスク】

(a) 会社がとっている配当政策について

(訂正前)

当社の配当方針につきましては、「第4 提出会社の状況、3. 配当政策」をご参照ください。

<中略>

#### ③ 製品の競合状況について

現在、当社製品は、遊技機器市場におけるグラフィックスLSI製品の分野において約50%の市場占有率となっているものと分析しております。当社といたしましては、同市場向け製品の高機能化や独自技術の開発を進めることにより更なる事業規模の拡大をめざしております。しかしながら、他の半導体メーカー等が当社製品の性能を凌ぐ製品を擁して参入を果した場合及び価額競争を強いられる状況等が発生した場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

④ ASSP製品の世代交代について

当社では、各種LSI製品の高解像度化をはじめとした高機能化や多機能化を実現することにより、事業規模の拡大を企図しております。当事業年度におきましては、遊技機器市場で使用される液晶表示装置の大型化及び高解像度化に対応した「AG301」の更なる販売数量の増加を実現することで事業規模の更なる拡大をめざしております。

しかしながら、遊技機器に搭載される液晶表示部の大型化（高解像度化）や高機能化の流れが、当社想定を大幅に下回る結果となった場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<中略>

(c) 当社の会社組織に係るもの

① 組織基盤の構築について

<中略>

(e) 生産及び販売体制について

① 製造を委託していることについて

当社は水平分業型ビジネスモデルを採用しており、製造設備を持たない研究開発型半導体メーカーとして研究開発業務に特化した事業活動を行っております。従いまして、当社製品の製造に関しては外部に製造を委託することとなりますが、当社の主たる事業でありますLSI事業にとりましてLSI製品等の製造委託は極めて重要な要素となっております。

このような認識の下、当社では、常に最適な製造委託先を確保できる体制を確立するとの観点から、総仕入高の約80%を委託する富士通マイクロエレクトロニクス株式会社をはじめとしてNECエレクトロニクス株式会社やローム株式会社等といった製造委託先と良好な関係を構築し、維持していくことが重要と考えております。

上記製造委託先の中で基本契約を締結している先の契約内容及び契約期間等につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5. 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。また、契約解除事由につきましては、債務の履行が困難になった場合や契約に違反した場合として各契約の条項に定められております。現時点において、当社と製造委託先との間で、これら契約に定められている契約解除条項に該当する事実はありません。現在、当社製品製造に係る必要な生産枠は確保できており、製造委託先との関係も良好な状態にあることから、当社が採用するビジネスモデルの継続に支障を来す要因は発生しておりません。更に、主要なLSI製品の製造を複数のメーカーに委託するなど、製品製造に係る補完体制の整備も推進しております。

しかしながら、各製造委託先において十分な生産枠が確保できない場合や通常想定することができない事象により製造委託先の設備に問題等が発生した場合、また、製造委託契約が終了した場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<中略>

③ 販売体制について

当社は水平分業型ビジネスモデルを採用しており、少人数の構成員による効率性を重視した組織運営を推進しております。当社製品の販売は、このビジネスモデルの態様として、商社を介した代理店販売を基本としております。現在、当社の販売代理店となっているのは、販売製品構成の関係等から当社売上高の90%超を占めている緑屋電気株式会社をはじめとしてインターニックス株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、株式会社リョーサン等であり、当社の事業活動における重要な要素を構成しております。

上記販売代理店の中で代理店契約を締結している先の契約内容及び契約期間等につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5. 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。また、契約解除事由につきましては、債務の履行が困難になった場合や契約に違反した場合として各契約の条項に定められております。現時点において、当社と販売代理店との間で、これら契約に定められている契約解除条項に該当

する事実はありません。現在、各販売代理店とは良好な関係を構築しており、当社が採用するビジネスモデルの継続に支障を来す要因は発生しておりません。更に、今後も販売代理店を介した販売体制の維持・継続・強化が重要な要素となるものと認識しており、今後の事業展開を踏まえて、新たな販売代理店との連携も必要になるものと考えております。

しかしながら、各販売代理店との関係構築に関する各種対応に問題が生じた場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<後略>

(訂正後)

当社の配当方針につきましては、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 3. 配当政策」をご参照ください。

<中略>

③ 製品の競合状況について

現在、当社製品は、遊技機器市場におけるグラフィックスLSI製品の分野において平成20年3月期において230万個の製品を販売しております。当社といたしましては、同市場向け製品の高機能化や独自技術の開発を進めることにより更なる事業規模の拡大をめざしております。しかしながら、他の半導体メーカーが当社製品の性能を凌ぐ製品を擁して参入を果した場合及び価額競争を強いられる状況等が発生した場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

④ ASSP製品の世代交代について

当社では、各種LSI製品の高解像度化をはじめとした高機能化や多機能化を実現することにより、事業規模の拡大を企図しております。今後におきましても、遊技機器市場で使用される液晶表示装置の大型化及び高解像度化に対応したグラフィックスLSI製品の更なる販売数量の増加を実現することで事業規模の更なる拡大をめざしております。

しかしながら、遊技機器に搭載される液晶表示部の大型化（高解像度化）や高機能化の流れが、当社想定を大幅に下回る結果となった場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<中略>

(c) 当社の会社組織に係るもの

① 特定人物への依存度について

<中略>

(e) 生産及び販売体制について

① 製造を委託していることについて

当社は水平分業型ビジネスモデルを採用しており、製造設備を持たない研究開発型半導体メーカーとして研究開発業務に特化した事業活動を行っております。従いまして、当社製品の製造に関しては外部に製造を委託することとなりますが、当社の主たる事業でありますLSI事業にとりましてLSI製品等の製造委託は極めて重要な要素となっております。

このような認識の下、当社では、常に最適な製造委託先を確保できる体制を確立するとの観点から、総仕入高の約80%を委託する富士通マイクロエレクトロニクス株式会社をはじめとしてNECエレクトロニクス株式会社やローム株式会社等といった製造委託先と良好な関係を構築し、維持していくことが重要と考えております。

上記製造委託先の中で基本契約を締結している先の契約内容及び契約期間等につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5. 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。なお、富士通マイ

クロエレクトロニクス株式会社との契約における解除条項は、①本契約に違反し、他の当事者より相当の猶予期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおこれを改めないとき及び②手形不渡事故・差押等の強制執行、破産、民事再生・会社更生・会社整理の申立等の理由により本契約に基づく債務の履行が困難になったときまたはそのおそれのあるときと定められております。現時点において、当社と製造委託先との間で、これら契約に定められている契約解除条項に該当する事実はありません。現在、当社製品製造に係る必要な生産枠は確保できており、製造委託先との関係も良好な状態にあることから、当社が採用するビジネスモデルの継続に支障を来す要因は発生しておりません。更に、主要なLSI製品の製造を複数のメーカーに委託するなど、製品製造に係る補完体制の整備も推進しております。

しかしながら、各製造委託先において十分な生産枠が確保できない場合や通常想定することができない事象により製造委託先の設備に問題等が発生した場合、また、製造委託契約が終了した場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<中略>

### ③ 販売体制について

当社は水平分業型ビジネスモデルを採用しており、少人数の構成員による効率性を重視した組織運営を推進しております。当社製品の販売は、このビジネスモデルの態様として、商社を介した代理店販売を基本としております。現在、当社の販売代理店となっているのは、販売製品構成の関係等から当社売上高の90%超を占めている緑屋電気株式会社をはじめとしてインターニクス株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、株式会社リョーサンであり、当社の事業活動における重要な要素を構成しております。

上記販売代理店の中で代理店契約を締結している先の契約内容及び契約期間等につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5. 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。なお、緑屋電気株式会社との契約における解除条項は、①所有物件又は権利につき、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申し立て又は租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき（但し、第三債務者として差押え又は仮差押えを受けた場合を除く。）、②支払停止があったとき、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生法の手続き開始の申し立てがあったとき、③手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けたとき、④監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき、⑤営業の廃止、重要な営業の譲渡又は会社の解散を決議したとき、⑥財政状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められるとき及び⑦当社及び緑屋電気株式会社は、本契約の全部又は一部に違背し、相手方からの通知又は催告によっても状態が治癒されない場合には、本契約に基づく一切の債務について、期限の利益を喪失するものとする」と定められております。現時点において、当社と緑屋電気株式会社をはじめとする各販売代理店との間で、これら契約に定められている契約解除条項に該当する事実はありません。現在、各販売代理店とは良好な関係を構築しており、当社が採用するビジネスモデルの継続に支障を来す要因は発生しておりません。更に、今後も販売代理店を介した販売体制の維持・継続・強化が重要な要素となるものと認識しており、今後の事業展開を踏まえて、新たな販売代理店との連携も必要になるものと考えております。

しかしながら、各販売代理店との関係構築に関する各種対応に問題が生じた場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

<後略>

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

(訂正前)

<前略>

### (2) 当事業年度の経営成績の分析

当事業年度の経営成績につきましては、「第2 事業の状況 1. 業績等の概要 (1) 業績」に記載しておりますのでご参照ください。当事業年度の経営成績に関する概要といたしましては、当社事業の中核製品である遊技機器市場向けグラフィックスLSI製品の市場占有率に特段の変化は無かったものと分析しており、前事業年度同様に概ね50%程度であったものと分析しております。

<中略>

### (3) 経営成績に重要な影響を及ぼす要因について

当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 4. 事業等のリスク」に記載してありますのでご参照ください。

### (4) 経営戦略の現状と見通し

当社が事業の中核と位置づける遊技機器市場向けグラフィックスLSI製品につきましては、高解像度対応、多彩な効果的描画演出機能の実現及び遊技機器に最適化された圧縮伸長技術の高度化等の高付加価値化を進めることにより事業規模の拡大を進め、同市場での市場占有率は概ね50%程度で推移しているものと分析しております。

<中略>

当事業年度までの遊技機器市場向けサウンドLSI製品につきましては、同市場において15%程度の市場占有率を獲得しているものと分析しており、当初の計画に沿う動きとなっております。

<中略>

また、市場ニーズの収集につきましては、組み込み機器の中でパソコン系の仕組みを前提としたシステムを搭載する機器に向けたグラフィックスLSI製品に対する需要が相当規模あり、このような機器に向けた新たなグラフィックスLSI製品の開発に着手しております。

<中略>

### (6) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社は、最先端の半導体設計技術を活かし、組み込み機器に向けたグラフィックスLSI製品をはじめとした各種LSIの製品化を事業の核とする革新的な研究開発型半導体メーカーであり、①高度な専門知識を持つ頭脳集団であること、②独自の新技术、新製品を創造すること、③工場を持たないファブレス企業であることなどを企業理念として掲げて実践しております。

<後略>

(訂正後)

<前略>

(2) 当事業年度の経営成績の分析

当事業年度の経営成績につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1. 業績等の概要 (1) 業績」に記載しておりますのでご参照ください。当事業年度の経営成績に関する概要といたしましては、当社事業の中核製品である遊技機器市場向けグラフィックスLSI製品の販売動向に変化はなく、前事業年度と同程度となる約230万個のLSI製品を販売しております。

<中略>

(3) 経営成績に重要な影響を及ぼす要因について

当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4. 事業等のリスク」に記載してありますのでご参照ください。

(4) 経営戦略の現状と見通し

当社が事業の中核と位置づける遊技機器市場向けグラフィックスLSI製品につきましては、高解像度対応、多彩な効果的描画演出機能の実現及び遊技機器に最適化された圧縮伸長技術の高度化等の高付加価値化を進めることにより事業規模の拡大を進め、平成16年3月期以降は各期200万個を超える製品販売を継続しております。

<中略>

当事業年度における遊技機器市場向けサウンドLSI製品につきましては、将来的な販売拡大に向けた営業活動を推進しており、堅調な販売動向となっております。

<中略>

また、市場ニーズの収集につきましては、組み込み機器の中でパソコン系の仕組みを前提としたシステムを搭載する機器に向けたグラフィックスLSI製品に対する需要があり、このような機器に向けた新たなグラフィックスLSI製品の開発に着手しております。

<中略>

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社は、当社が有する半導体設計技術を活かし、グラフィックスLSI製品をはじめとした各種LSIの製品化を事業の核とする研究開発型半導体メーカーであり、ファブレス形式のビジネスモデルを採用しながら独自技術の開発や新製品の創造に向けた活動に注力することを企業理念として掲げて実践しております。

<後略>

## 第4【提出会社の状況】

### 3【配当政策】

(訂正前)

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当金額につきましては、配当性向主義の採用により、業績に応じた配当額を基本として、事業計画などから必要と目される内部留保資金等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、内部留保資金の活用方針につきましては、他社技術の機動的な導入や中長期的視点に立った研究開発活動の資金として使用する方針であります。

当事業年度の配当額は、上記方針に基づき1株当たり14,500円00銭(中間配当5,000円00銭及び期末配当9,500円00銭)とし、配当性向は50%となりました。なお、当事業年度の配当額につきましては、当初計画を上回る当期純利益となりましたため、配当額の見直しを行い1株当たり期末配当金を当初期末配当予想額より4,500円増加いたしました。

翌事業年度の配当計画は、当事業年度と同様の配当性向50%を基準とする配当額を計画しております。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めており、中間配当(取締役会を決定機関とし、毎年9月30日を基準日とする配当)と期末配当(株主総会を決定機関とし、毎年3月31日を基準日とする配当)の年2回の支払を実施しております。

<後略>

(訂正後)

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきましては、今後の事業計画や事業規模の拡大に向けた内部留保資金の充実を勘案しつつ、期間収益を積極的に還元していくことを基本方針としております。具体的には、配当性向50%を基準として配当を実施してゆく所存であります。

当社は取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回配当を実施することとしております。これら配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の配当額は、上記方針に基づき1株当たり14,500円00銭(中間配当5,000円00銭及び期末配当9,500円00銭)とし、配当性向は50%となりました。当事業年度の配当額につきましては、当初計画を上回る当期純利益となりましたため、配当額の見直しを行い、1株当たり期末配当金を当初期末配当予想額より4,500円増加いたしました。

翌事業年度の配当計画は、当事業年度と同様の配当性向50%を基準とする配当額を計画しております。

内部留保資金につきましては、他社技術の機動的な導入や中長期的視点に立った研究開発活動の資金として使用する方針であり、今後も継続的な企業価値向上に努めてまいります。

<後略>